

证券代码：300782

证券简称：卓胜微

江苏卓胜微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-006

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他（电话会议）
-----------	---

	定基础；在技术维度，公司持续布局 6 英寸特种工艺、12 英寸异质硅基工艺平台及先进异构集成三大核心技术平台，通过延展“异质+异构”的技术路线，协同优化材料、工艺、器件与封装等环节，持续完善差异化、高端定制化、高度集成化等系列产品，着力强化“资源平台领先、产品领先、成本领先、质量领先”的综合优势。 二、在问答环节，主要回复如下： 1、请问公司关于二季度业绩表现及影响因素，以及对未来季度的预期情况？ A：尊敬的投资者，您好！2025 半年度，受行业需求淡季的影响，公司营业收入 17.03 亿元，较去年同比下降 25.42%。归属于上市公司股东的净利润-1.47 亿元，同比下滑 141.59%。 随着芯卓产线顺利量产，其中最重要的部分也即设备投入最大的 12 英寸射频开关、低噪声放大器工艺线在去年年中进行了大规模量产转固。去年下半年，产能爬坡初期产能利用率不足导致单片实际成本异常。该部分成本较高的晶圆经后道加工成产品，在 2025 上半年销售给客户后，对公司的毛利率和盈利能力表现产生了较大扰动。同时，受到市场竞争与芯卓折旧金额增加的多重影响，公司毛利率下滑至 28.75%。 随着芯卓产品持续上量，产线运转效率提升，降本拐点等迹象陆续出现，预计后期相关产品毛利将企稳回升。 公司上半年处于新产品的导入期，在新产品方面取得了较大进展，包括 L-PAMiD、WiFi7 模组产品以及低功耗蓝牙芯片、车规超宽带 UWB 芯片等，这些新产品将进一步体现其价值。感谢您对公司的关注！ 2、请问公司中短期经营布局？ A：尊敬的投资者，您好！公司上市后，重点在于布局自身能力，推进射频全产业链和全系列产品的发展。得益于工艺和技术资源平台的建设，公司产品于技术革新、供应链优化、市场拓展等多维度实现突破的空间格局已然向上打开。目前，公司已具备了全品类射频前端解决方案的能力。下一阶段公司将聚焦于完善高端产品，持续依托自建产线完善产品线布局并向更多市场有序推广高性能产品。 公司将持续夯实在射频领域的布局，在保持并深入拓展手机等移动智能终端领域的同时，锚定移动通信、WiFi 无线连接、短距通信等方向持续加码研发投入，关注 AI 带来的智能硬件、智能设备、可穿戴的市场机会，积极打造基于短距通信感知一体的 SoC 芯片技术体系，布局短距离通信感知的系统解决方案和能力，在未来力争拓展到 IoT、智能家居、健康监测、汽车电子等应用场景。感谢您对公司的关注！
--	---

3、请问公司的先进封装的进展？

A：尊敬的投资者，您好！截至 2025 半年度末，部分采用先进封装技术的产品顺利通过关键客户验证已实现规模出货；专为先进集成工艺打造的产线已成功实现从技术落地到规模化量产的闭环，为公司持续深化射频前端模组在小型化、低成本、高性能方向的产品开发奠定了坚实的基础。先进封装技术适用于如智能眼镜等对尺寸和形态有较高要求的产品。目前相关产品已在部分客户项目中推进，但整体仍处于早期阶段。感谢您对公司的关注！

4、请问公司目前的产能规划情况，后期扩产是否会仍会经历投产爬坡和折旧高峰的问题？

A：尊敬的投资者，您好！目前公司 6 寸及 12 寸产线产能利用率逐步提升，未来将根据市场及工艺投入情况反馈，综合生产资源和技术资源，逐步调整或扩充产能。

当前公司产能第一阶段已形成较好平台优势。后续扩充产能并非对原有设备整体规模倍增，而是基于已有设备潜力进行关键环节的补充。因此，后期折旧及转固金额的增加预计低于早期设备折旧金额。尽管阶段性折旧仍会对毛利产生一定扰动，但其影响小于产线初期影响。感谢您对公司的关注！

5、请问公司相关专利和诉讼的进展？

A：尊敬的投资者，您好！卓胜微的技术路线发展及演进，是公司长期多维布局的自然成果。围绕该路径，公司在资源投入、专利布局与生态协同方面进行了长期的、正向的建设，构建了系统性的能力体系，并希望通过健康的竞争推进产品、技术及行业的演进。公司对村田主张不予认可，并针对涉案的专利提起了专利无效的申请，目前相关的无效案件正在审理过程中。此外，公司已经完成了在韩国、上海专利无效申请的提交。感谢您对公司的关注！

6、请问公司存货增加的原因？

A：尊敬的投资者，您好！公司自有产线运转良好，且截止报告期末产能爬坡顺利，产能利用率逐步提升。由于生产周期中涉及原材料种类众多，部分原材料的交期较长，为保证产线长期的高效且稳定产出，公司相应增加了相关原材料的储备。感谢您对公司的关注！

7、物联网芯片，低功耗的物联网处理器芯片是硅基还是 SOI 芯片，其目标市场和应用场景是什么？

A：尊敬的投资者，您好！公司低功耗物联网处理器芯片是硅基芯片。公司的低功耗物联网处理器芯片产品主要应用于智能家居、可穿戴设备、

	智能汽车等领域。未来随着智能终端、物联网、AI 等行业的发展，预计将迎来更多的市场机遇。感谢您对公司的关注！ 8、请问公司目前 WiFi7 模组下游应用的构成情况？ A： 尊敬的投资者，您好！在 WiFi 无线连接领域，公司取得了较大的进展。报告期内，WiFi7 模组产品已实现规模化量产并保持稳定出货态势。目前该产品主要应用于手机产品中，未来也将积极拓展如路由器等更多的应用领域。感谢您对公司的关注！
附件清单 （如有）	无
日期	2025 年 8 月 22 日